

证券代码：002916

证券简称：深南电路

### 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-11

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	招商证券、博时基金、国信证券、花旗银行、中信建投证券、开源证券、野村证券、东吴证券、民生证券、中金公司等
时间	2020年10月28日-11月11日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书：张丽君；证券事务代表：谢丹。
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>交流主要内容：</b></p> <p><b>Q1、请简要介绍公司三季度的经营情况。</b></p> <p>公司2020年1-9月营业收入为89.83亿元，同比增长17.29%；实现归母净利润10.98亿元，同比增长26.6%。其中2020年第三季度营业收入为30.67亿元，同比增长7%，实现归母净利润3.74亿，同比下降5.69%。8月中下旬之后，通信市场需求出现波动，对公司三季度业绩带来一定影响，产能利用率较高峰期有所回落。</p> <p><b>Q2、公司三季度归母净利润同比变动原因。</b></p> <p>公司第三季度利润同比有所下降，主要受汇兑损失、可转债利息和研发投入增加等因素影响。</p> <p><b>Q3、请介绍公司三大业务在三季度的营收占比情况。</b></p> <p>较2020半年度数据相比，三季度PCB业务营收占比略有提升；电子装联业务营收占</p>

比有所降低；封装基板业务营收占比基本持平。

**Q4、目前 5G 产品在 PCB 产品总量占比有多少？**

较 2020 半年度数据相比，第三季度受通信领域整体需求的影响，5G 产品在 PCB 产品总量中的占比有所回落。

**Q5、三季度原材料采购价格对公司是否存在影响？**

公司生产 PCB 的主要原材料为覆铜板（CCL），目前整体保持较平稳的态势，未出现明显变化。

**Q6、PCB 业务除通信之外其他重点领域的情况？**

除通信之外，今年以来，PCB 业务在数据中心领域同比保持较快增长；工控医疗领域市场保持稳定增长，占比较去年同期有所提升；汽车电子领域，三季度以来随外部整体市场逐步回暖，但占公司营收比例较低。

**Q7、公司封装基板业务的发展态势如何？**

公司封装基板业务维持较高景气，在声学类微机电系统封装基板产品（MEMS-MIC，即硅麦克风）技术和产量上继续保持领先优势，指纹类、射频类、存储类等封装基板产品均保持良好态势，当前业务重点在于大客户开发及关键项目的争取。

**Q8、存储类基板产品的客户开发情况？**

存储类基板产品相关客户开发符合预期，已有部分客户已进入量产阶段。

**Q9、关于服务器领域的需求，鉴于服务器领域要进行平台切换升级，这对于产品价值量的提升有何影响？**

受疫情等各方面因素影响，平台切换的时间有所延缓，下一代服务器的电路板目前尚处于研发阶段。下一代服务器 PCB 产品在材料、线条密度、层数方面有更高要求，并应用部分特殊工艺，基于上述成本因子的带动，预计产品价值量会有所提升。

**Q10、公司目前在汽车电子领域的业务布局是怎样的？未来会有较大的投入么？**

	<p>汽车电子是公司看好并重点发展的领域之一，新能源汽车和 ADAS 是目前公司在汽车电子领域发展的主要方向。目前公司在汽车领域业务占比并不高，未来有较大的成长空间。公司已积极投入汽车电子相关技术研发，积累生产能力，并已与国内外部分知名厂商开展合作。伴随未来 5G 建设逐步完善，各类终端应用（车联网、物联网等）涌现，汽车也可能成为大的移动终端，公司在通信领域的技术优势将有机会进一步得到延伸。公司在充分判断风险的前提下，已经有序开展新工厂的基础建设筹备，具体建设和投资进度仍需要实际参考客户及市场需求的情况。</p> <p><b>Q11、三季度海外客户订单情况如何，海外疫情对公司的影响如何？</b></p> <p>二季度受疫情影响，海外客户占比有所下降，三季度海外客户需求有所回升，境外收入占比有所增加。</p> <p><b>Q12、目前公司各业务产能利用情况如何？</b></p> <p>8 月中下旬后，受通信市场整体需求波动影响，PCB 业务综合产能利用率开始有所回落；PCBA 业务除通信类产品受一定影响外，其他产线产能利用率较高；封装基板业务除无锡基板工厂在爬坡外，其余工厂整体保持较高的产能利用率。</p> <p><b>Q13、公司各募投项目进展情况如何？</b></p> <p>报告期内，公司两个重要募投项目有序推进爬坡，其中 PCB 业务的南通数通二期于今年 3 月份连线生产，目前产能爬坡推进较为顺利；封装基板业务的无锡基板工厂于 2019 年 6 月连线试生产，客户开发进展顺利，爬坡进展符合预期。</p> <p>注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2020 年 11 月 13 日